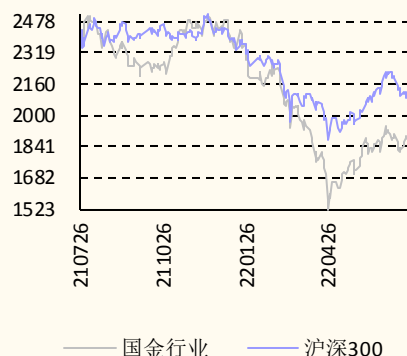


市场数据(人民币)

市场优化平均市盈率	18.90
国金信息技术产业指数	1877
沪深 300 指数	4238
上证指数	3270
深证成指	12394
中小板综指	12744


相关报告

1. 《需求结构性机会仍需关注，国产替代趋势不改-创新技术中心双周报...》，2022. 7. 10
2. 《电源行业水大鱼大，加码新能源未来可期-电源行业深度》，2022. 7. 10
5. 《弱周期弱成长，聚焦于细分领域更具投资性-A股PCB投资框架浅...》，2022. 7. 1

樊志远 分析师 SAC 执业编号: S1130518070003
(8621)61038318
fanzhiyuan@gjzq.com.cn

邵广雨 联系人
shaoguangyu@gjzq.com.cn

赵晋 分析师 SAC 执业编号: S1130520080004
zhaojin1@gjzq.com.cn

至暗时刻已过，关注下游需求逐步改善

投资建议

- **电子行业观点：电动汽车 800V 时代来临，碳化硅迎来甜蜜时刻，国内碳化硅衬底公司签订大单。**在电动汽车 800V、高压快充及光伏储能的拉动下，碳化硅需求旺盛，目前 SiC MOSFET 出现了供不应求的情况，随着蔚来 ET5\ET7、小鹏 G9 等搭载碳化硅车型的交付及放量，而衬底及晶圆厂技术壁垒较高，产能扩张较慢，SiC MOSFET 紧缺情况有望进一步加剧。天岳先进发布公告，公司与某客户签订长单，约定 2023 年至 2025 年交付 6 寸导电型碳化硅衬底，预计含税销售三年合计金额为 13.93 亿元。台积电 Q2 HPC 营收占比提升，手机业务占比下滑。台积电 2022Q2 业绩说明会表示，HPC 业务增长表现强劲，22Q2 HPC 营收环比增长 13%，占比由 Q1 的 41%进一步提升至 43%，7nm 及以下的先进制程占比合计已经高达 51%；手机需求疲软，台积电 22Q2 占比由一季度 40%下滑至 38%，根据 Canalys 数据，2022Q2 全球智能手机出货量同比下降 9%。我们继续看好新能源及智能汽车用电子半导体的机会，重点看好 IGBT、碳化硅、薄膜电容、隔离芯片、智能汽车产业链。
- **通信行业观点：通信板块三季度基本面向好，重点关注数字新基建和高成长。**结合通信板块公布的二季度业绩预报和产业链调研情况判断，5G、云等数字新基建板块二季度保持平稳增长，光通信、物联网模组、数字能源相关上市公司增速较快，展望三季度我们预计物联网智控器、智能汽车相关公司将出现较大边际改善。同时随着下半年稳增长举措的不断落地和推进，数字新基建板块景气度有望逐步提升，5G、云、光网络、物联感知、卫星互联网等新型 ICT 基础设施供应链中市场格局好、具备规模效应的头部公司将重点受益。从下游场景看，高景气赛道主要集中在通信和垂直行业相融合的 AIoT、数字能源、智能汽车等新兴细分领域，在疫情反复、供应链波动等诸多不确定下，相关领域的部分头部公司年稳态增长预期仍将保持在 30%左右的水平。建议重点关注移远通信、和而泰、拓邦股份、光庭信息、经纬恒润、中国移动、宝信软件等。
- **计算机行业观点：近期计算机指数表现靠后，主要临近中报，更多的开始反应 Q2 业绩受疫情影响的预期，叠加市场风险偏好的回落，因而总体表现偏弱；本周反弹幅度靠前，主要是受鸿蒙 3.0 发布事件催化主题投资；目前板块主线还是下游高景气或映射 A 股热度的智能驾驶、工业软件、电力 IT 等，夹杂一些题材热点，若综合考虑基本面趋势与估值分位的性价比，人工智能、信息安全、金融科技下半年的机会值得关注。**
- **推荐组合：澜起科技、立昂微、北方华创、兆易创新、法拉电子、移远通信、光庭信息、海康威视、恒生电子、奇安信。**
- **风险提示：新能源车/手机销量低于预期、智能化配置不达预期、估值偏高**

内容目录

一、 细分行业观点.....	4
1、 半导体设备及材料.....	5
2、 半导体设计领域.....	5
3、 新能源、消费电子、功率半导体.....	6
4、 汽车电子.....	6
5、 PCB 行业.....	7
6、 智能汽车.....	8
7、 云计算产业链.....	8
8、 物联网产业链.....	8
9、 计算机产业链观点.....	9
二、 行业重要资讯	10
三、 行业数据	14
1、 报告期内行情.....	14
2、 全球半导体销售额.....	15
3、 中关村指数.....	15
4、 台湾电子行业指数变化.....	16
5、 台湾电子半导体龙头公司月度营收.....	18
四、 风险提示	19

图表目录

图表 1: 国金 TMT 深度及投资组合更新.....	4
图表 2: 报告期内 A 股各版块涨跌幅比较 (07/11-07/24)	14
图表 3: 报告期电子行业涨跌幅前五名 (07/11-07/24)	15
图表 4: 全球半导体月销售额.....	15
图表 5: 中关村周价格指数.....	16
图表 6: 台湾电子行业指数走势	16
图表 7: 台湾半导体行业指数走势.....	17
图表 8: 台湾电子零组件指数走势.....	17
图表 9: 台湾电子通路指数走势	18
图表 10: 鸿海月度营收	18
图表 11: 广达月度营收	18
图表 12: 华硕月度营收	18
图表 13: 鸿准月度营收	18
图表 14: 臻鼎月度营收	19
图表 15: 健鼎月度营收	19

图表 16: 欣兴月度营收	19
图表 17: 台光月度营收	19

一、细分行业观点

图表 1：国金 TMT 深度及投资组合更新

组别团队	股票代码	公司	推荐理由
电子团队	688008	澜起	DDR5 上市，内存接口通道数增加，津逮爆量
	688099	晶晨股份	1) 智能机顶盒升级，需求旺盛，海外运营商客户持续拓展，整体市占率有望提升 10 个 pct；2) WiFi 芯片和车载芯片业务增长迅速，成为未来 5 年新动力。
	300327	中颖电子	1) 电池管理芯片 2022 年在国内手机品牌客户份额快速提升；2) OLED 驱动芯片下半年有望取得突破
	605358	立昂微	硅片行业产能供不应求持续到 23 年，公司 12 寸快速上量；公司相关光伏、车用功率器件景气度持续。
	002371	北方华创	订单饱满，产销两旺，下游需求持续扩容，盈利能力快速提升，未来业绩增长具备较高确定性。
	603986	兆易创新	MCU 结构优化明显（预计 22 年工业+汽车用占比超 50%），自研 DRAM 大规模上量，预计 22 年收入至少 16 亿元，NOR 中高容量占比提升，到 2025 年全球市占率有望提升到 25%。
	300207	欣旺达	消费电子电池业务稳健增长，驱动力主要来自于 iPhone 销量增长及平板、笔电份额提升；消费电子电芯业务快速发展，并有望导入 A 客户；动力电池业务 2022 年有望翻倍以上增长，盈利能力大幅改善。
	600563	法拉电子	公司在薄膜电容领域国内第一，全球前三，在电动汽车领域，全球市占率 30%，国内市占率 40%。公司薄膜电容产能逐步在提升，扩产主要在车和光伏风电领域，今年车用扩产 100-150%，光伏扩产 50%。薄膜电容行业竞争壁垒较高
	688300	联瑞新材	高精尖材料国产替代新军，自身阿尔法属性强，至 2025 年复合增长 50% 确定性高
	688800	瑞可达	业绩拐点确立，受益新能源车销量高增、换电模式渗透率提升明年业绩翻倍增长
通信团队	603236	移远通信	利润进入释放期，2022 年利润有望翻番，全球出货量份额从 40% 向 70% 挺进，未来五年利润预期 CAGR 50%+
	000977	浪潮信息	1) 云计算产业链持续高增长，数字经济建设拉动服务器等算力基础设施；2) 2022 年 Intel Sapphire Rapids 与 AMD Genoa 导入市场有望推动换机潮；3) 估值相对较低。
	300627	华测导航	农机、位移监测有望保持 50% 以上增速，车载业务已被指定为哪吒和路特斯的自动驾驶位置单元的定点供应商，年底量产。新业务带动营收增速 30%+
计算机	600570.SH	恒生电子	行业层面：券商 IT 支出持续高景气，全面注册制带来边际催化；公司层面：22 年人效及扣非净利率提升；23 年由于股份支付减少，扣非净利率有望进一步提升。
	002415.SZ	海康威视	行业层面：第一成长曲线安防稳健增长；第二成长曲线数字化、智能化在 PBG、EBG 落地趋势明朗；第三成长曲线八大创新业务势头迅猛；公司层面：15-18 年转型高投入期已过，18-20 年外部环境负向影响基本见底改善；21-23 年公司明确为发展机遇期，复合增速回升。近期外媒报道可能面临列入 SDN list 制裁，我们综合判断进入概率极低，股价回调已基本反映较悲观预期。
	300803.SZ	指南针	行业层面：需求稳定向好，受疫情影响较小；公司层面：收购网信证券，有望复制东方财富成长之路；从下半年开始正式开启经纪业务。
	002410.SZ	广联达	行业层面：施工业务受宏观环境影响；造价业务受影响小；稳经济措施有利于需求环境回暖；公司层面：在手订单充裕，造价业务单季收入确认来自单季订单的权重很低，因此受疫情影响不明显；而造价新签订单在订阅制商业模式下平滑波动；施工业务在 21 年下半年有望进入拐点。
	688561.SH	奇安信	行业层面：受益数字化转型大浪潮，政策、事件持续催化，信息安全蓬勃发展；公司层面：

来源：国金证券研究所

1、半导体设备及材料

- **半导体代工制造：台积电公布二季度业绩，HPC/汽车业务增长强劲，小幅下调 22 年资本开支。**台积电 7 月 14 日发布 2022 年第二季度财报，22Q2 营收 181.6 亿美元符合预期，毛利率 59%超预期，22Q3 营收指引中值环比增长 11%。16nm 及以下先进制程收入占比环比继续提升，HPC/汽车业务增长强劲。先进制程方面，预计 N3 将于 22 年下半年生产，N2 预计 2024 年风险量产，N2 相比 N3E 在速度提升 10%-15%，功耗降低 20%-30%。原计划 2022 年全年资本支出 400-440 亿美元，预计今年公司的一部分资本支出将被推迟到 2023 年，2022 年全年资本支出水平可能会接近全年指引下限（400 亿元），但是 2022 年扩产计划不会受到影响。智能手机和 PC 等消费类需求下降，数据中心和汽车需求稳定，去库存周期预计持续几个季度。
- **半导体设备行业：ASML 在手订单创新高，美国半导体法案初步通过限制对中国大陆投资。**7 月 19 号美国“芯片法案”在国会参议院通过，用 520 亿美元的财政支持来提振美国的半导体行业，同时规定获得美国相关补助的企业，在美国建立了工厂，就不能在 10 年内扩大对中国先进制程芯片的投资。此外美国也正在推动荷兰禁止 ASML 向中国出售 DUV 光刻机及其他设备以遏制中国半导体的崛起。我们持续看好半导体设备和材料国产化大趋势，国产替代有望进一步加速。ASML 二季报情况来看，目前在手 330 亿欧元订单，Q2 订单 85 亿欧元还是创了历史新高，其中 EUV 订单 54 亿欧元。根据 ASML，虽然部分客户在一些消费导向的细分市场中透露出需求放缓的信号，但在汽车、高性能计算和绿色能源转型等全球大趋势的推动下，市场对光刻机的需求仍然强劲。从目前公布的中微公司、北方华创、华海清科中报预告来看，营收保持较高增速符合预期，业绩均超预期增长，国产设备公司利润陆续开始释放。国产份额的提升仍然是半导体设备的核心逻辑，关注部分产线的建设及招标进展。持续推荐北方华创，长川科技，拓荆科技，华海清科，中微公司，华峰测控等公司。
- **半导体材料行业：持续推荐具备建设半导体材料平台的技术基础，打开长期成长空间的公司，鼎龙股份、江丰电子、安集科技等。**江丰电子国内半导体靶材龙头，2022H1 业绩高增长超预期，2022Q2 单季度实现归母净利润 1.15-1.33 亿元，环比+244.2-298.6%，预告中值对应归母净利率 20.8%，同比+11.5pcts，环比+14.8pcts，公司积极推进原材料国产化带来成本下降，通过对半导体靶材产线智能化改造提升产能。零部件需求旺盛，公司零部件产品供不应求，销量迅速增长，同时规模效应下，盈利能力持续提升。

2、半导体设计领域

- **汽车电动化与智能化加速，关注智能座舱 Soc 需求增长。**7 月 18 日，工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车推进组（ICV-2035）2022 年度工作会议。装备工业一司强调，要进一步把握产业变革趋势和发展脉络，持续加强重大问题研究评估，强化各方资源力量协调，加快开展智能网联汽车准入管理试点，推动关键核心技术研发应用，组织更大范围更多场景测试示范，同步推进法规政策完善、技术标准制定、产业生态建设等各项工作，努力推动我国智能网联汽车产业更好更快发展。7 月 22 日，乘联会表示，据 7 月厂商零售目标调研和周度销量走势等数据，初步推算出 7 月狭义乘用车零售销量 177 万辆，同比增长 17.8%；新能源零售销量 45 万辆，同比增长 102.5%。汽车智能化与电动化持续加速，我们看好智能座舱 Soc 的需求增长，根据 IHS 数据显示，2021 年全球/中国市场座舱智能配置水平的新车渗透率约为 49.4%/53.3%，预估到 2025 年国内渗透率将超过 75%，高于全球 59.4%的水平。2021 年，全球汽车 SoC 市场规模为 48 亿美元，预计 2025 年将达到 82 亿美元。
- **从供给端看，主要为传统座舱芯片厂商与消费电子厂商两类：**1) 传统汽车芯片厂商，主打中低端市场：NXP、德州仪器、瑞萨电子等，出于对研发成本的考量，制程、算力升级积极性较差。2) 消费电子厂商，主打高端市场：高通、联发科、三星等，凭借性能及迭代优势在中高端市场快速发展，

市场份额有望持续提升。如高通的座舱 SoC 芯片融合了 GPU、CPU、AI 等模块和全面的网联能力，在智能化发展之初获先发优势，目前已成功供货国内造车新势力如领克、理想和小鹏等，并打入大众、本田、路虎等海外客户供应链。最新推出的第四代座舱平台 SoC 采用了目前最为先进的 5nm 工艺，算力继续升级的同时亦提升了可支持的显示屏及摄像头数量，未来领先优势有望持续。2021 年，高通在智能座舱 Soc 领域占据超 70% 份额。

- **国内芯片厂以地平线、芯驰科技、华为、瑞芯微、晶晨股份、全志科技等为代表入局智能座舱 SoC 芯片市场。**华为麒麟 990 的 CPU 算力超过 75KDMIPS；芯驰科技最新推出的座舱芯片 X9U 的 CPU 算力达到 100KDMIPS；瑞芯微最新推出的智能座舱芯片 RK3588M CPU 算力也达到 100KDMIPS；地平线基于征程 2 打造包括 DMS、人脸识别、语音识别等功能在内的智能座舱解决方案，已搭载长安 UNI-T、理想 ONE。我们认为，随着越来越多的主机厂倾向于硬件预埋、主机厂间的算力竞赛越来越白热化，高算力 SoC 芯片厂商的议价权也将进一步提升。推荐关注地平线、瑞芯微、晶晨股份、全志科技等国产智能座舱 Soc 芯片厂商，

3、新能源、消费电子、功率半导体

继续看好新能源及智能汽车用电子半导体，建议关注低估值龙头。

- **台积电 Q2 业绩说明会表示高性能计算、物联网和汽车等行业需求继续强劲。**在台积电 Q2 业绩会上，CFO 黄仁昭（Wendell Huang）表示，Q2 受益于高性能计算、物联网和汽车等行业的强劲需求，拉动公司营收环比增长 8.8%，毛利率环比增长 3.5 个百分点至 59.1%，高于市场预期。财报显示，台积电 Q2 营收 5341.41 亿台币（181.6 亿美元），同比增长 43.5%；净利润为 2370 亿元台币（85.04 亿美元），同比增长 76%。
- **ASML 确认创纪录的季度预订量。**全球最大的光刻工具生产商 ASML 公布其 2022 年第二季度收入为 54.31 亿欧元，同比增长 53%。在第二季度，该公司共提供（确认收入）91 个新光刻系统（高于 2021 年第二季度的 59 个），其中 12 个是 EUV 系统（高于 2021 年第二季度的 3 个）。
- **降低缺芯影响，大众、特斯拉、上汽有大动作。**在特斯拉 2022 财年第二季度财报会上，CEO 马斯克对外谈及了芯片问题，其表示当前供应链面临挑战，芯片方面特斯拉没有必要自己制造芯片，因为公司会与供应商合作，目前特斯拉已经使用了大量定制芯片。同时，特斯拉还将通过改写软件等方式减少芯片使用，以应对芯片供应难题。大众集团联手意法半导体与台积电，确保未来芯片供应。7 月 20 日，大众集团旗下 CARIAD 软件公司表示将与意法半导体联合开发用于汽车的系统级芯片（SoC），根据协议，CARIAD 与意法半导体计划选择台积电生产 SoC，以确保未来数年的芯片供应。在汽车芯片领域，上汽集团已投资地平线、晶晨半导体、芯钛科技、芯旺微电子等 20 余家芯片公司，不断加快汽车芯片产业链布局；同时，上汽与上海微技术工业研究院合作，共同搭建汽车电子芯片第三方联合评价平台，减少芯片企业重复认证投资并缩短认证周期，促进车规级芯片的国产化。
- **新能源行业（电动汽车、充电桩、光伏、风电、储能等）需求旺盛，新能源用电子半导体迎来了新的发展机遇，我们看好重点受益的锂电材料/动力电池、功率半导体（IGBT、碳化硅）、薄膜电容、隔离芯片、连接器等细分行业。重点受益公司：法拉电子、江海股份、斯达半导体、纳芯微、新洁能、天通股份、士兰微、晶盛机电、时代电气、东微半导、立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、东山精密、扬杰科技、三安光电、唯捷创芯、欣旺达、杉杉股份、顺络电子、三环集团、洁美科技。**

4、汽车电子

- **7月新能源车需求环比趋弱，智能车渗透率持续提升。**1) 根据乘联会，由于大量消费需求已于6月快速释放，7月内购置税减半政策对车市整体支撑性趋弱，短期刚需购车迫切性下降，中高端需求成主力，预计7月乘用车销量为177万辆、同增18%、环减9%，新能源车销量45万辆、同增103%、环减15%，渗透率为25%。2) 根据高工智能汽车研究院的数据显示，2022年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车新车整体ADAS（L0-L2）搭载率达47%；其中L2级ADAS前装搭载率已达27%、较去年同期提升11pct。在行车ADAS份额方面，本土Tier 1供应商占比达8.9%，较去年同期提升3pct。
- **车载连接器：**高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%，高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%，低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代，汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达（车载高压业务收入占比75%），高速连接器龙头电连技术（车载高速业务收入占比10%）。短期建议关注永贵电器。
- **车载光学：**智能驾驶方兴未艾，车载光学持续升级。2020年全球单车搭载摄像头数量仅2颗，新势力车型搭载摄像头数量普遍达到8~13颗，未来5年行业CAGR达40%。长期看好光学龙头舜宇光学科技（车载光学收入占比8%，车载镜头全球市占率超30%）、宇瞳光学。
- **车载显示：**短期来看，我们看好汽车智能化（大屏化+多屏化）对显示屏需求的拉动，长期来看，我们看好屏厂借助屏幕资源向下游车载显示系统领域延伸、抢占千亿级市场中传统tier1的份额。长期看好京东方精电、宸展光电。

5、PCB 行业

- **PCB 板块：二季度稳定增长，需求变化决定板块增长效应。**二季度板块收入同比承压但环比平稳，归母净利润同比和环比均有稳定增长，原因主要是在于去年通货膨胀带来爆发式需求，在这种情况下 PCB 行业订单出现爆满现象、收入端成长迅速，但同样由通货膨胀催生的价格泡沫使得原材料成本大幅上涨，PCB 作为议价能力较弱的产业链环节盈利明显受挫，而今年二季度与去年刚好相反，即二季度因战争、国内疫情影响导致需求疲弱，PCB 行业营收端顺势承压，但大宗商品价格回落使得 PCB 行业盈利同比环比均处于改善的趋势中，因此我们认为 Q2 板块盈利均有稳定的表现。从细分领域上来看，二季度订单保持饱满的下游需求主要有两个维度：其一从领域上来看新能源车相关领域的订单饱满度高，主要是受益于新能源车加速渗透，其次服务器因海外资本开支和新平台换代 NPI 使得订单相对饱满，而其他领域需求不尽人意，如消费电子砍单不断导致需求极其疲弱、通信基建订单仍然未启动拉货、传统汽车受到疫情和成本双重压力需求承压明显、工控医疗需求保持；其二从订单来源上来看，布局海外较多的厂商订单也较为饱满，原因主要来自国内二季度受到疫情影响严重而海外疫情恢复之后的需求存在补偿效应，因此承接海外订单的公司订单相对较好且能够受益于汇兑。
- **CCL 板块：成本端优化趋势确定性强，龙头阿尔法有望迎单位毛利反转。**二季度板块无论是收入还是利润都会环比和同比下降，且同比降幅较大，原因主要在于去年通货膨胀带来价格涨价契机、21Q2 覆铜板价格和盈利水平处于高位，而今年无论是需求端还是原材料价格端都不存在对 CCL 的价格和盈利的支撑，因此今年覆铜板市场价格会逐季降低，22Q2 覆铜板板块所有公司几乎都会面临收入和盈利、同比和环比双双大幅下降的局面。基于此我们认为二季度整个板块所有公司都不存在业绩超预期的机会，但龙头公司或存在利空出尽后的估值修复，原因在于随着大宗商品价格下降，阿尔法能力强的龙头公司能够在保证自身订单量的情况下使得单张毛利反转（产品降价幅度小于原材料降价幅度），从而带来业绩反转、超预期机会，一旦基本面反转，封装基板、服务器、MiniLED、高频高速、汽车等相关领

域的高端产品渗透能够提升公司估值水平，从而迎来戴维斯双击机会。基于上述逻辑，我们主要推荐生益科技。

6、智能汽车

- **全球百大汽车零部件供应商此消彼长，中国汽车供应链迎来“换道超车”机遇。**近日，《美国汽车新闻》（Automotive News）发布了 2022 年全球汽车零部件供应商百强榜，日本上榜企业最多共有 22 家，美国 21 家，德国 18 家。中国汽车零部件供应商发展迅速，上榜家数由 21 年的 8 家上升至 10 家。我们认为，汽车智能化升级推动产业格局生变，国产汽车出海加速，自主品牌国内市占率有望从 21 年的 44% 提升至 2030 年的 60%，将带来本土供应商崛起新机遇。燃油时代，美国凭借强大的工业体系和领先的内燃机驱动、制动技术，牢牢掌握着整车产业链的话语权；电气时代，日本和欧洲企业及时向电动化领域布局，在核心领域三电和热管理方面占得领先优势。自 2009 年起，中国一直是全球第一大汽车产销国，2021 汽车销量达到 2100 万辆，国产供应链崛起已具备市场基础。另一方面，智能网联化开启汽车行业变革下半场，新赛道洗牌是国产替代的核心催化剂。2021 年全球新能源车型累计销量近 650 万辆，较去年同期增长 108%，渗透率达到 8%。当前，电动化、网联化、智能化推动汽车产业正发生新一轮深刻变革，以经纬恒润、德赛西威为代表的一批中国本土零部件厂商积极布局，有望打破汽车供应链体系被海外龙头垄断的局面，实现“换道超车”。

7、云计算产业链

- **建议重点关注有催化因素的个股，如：激光雷达业务有所突破的光通信厂商，以及电网投资超预期带来的电网 IT 及云计算机会。**
- **【云计算基础设施】**本周中际旭创、天孚通信关注度显著提升，主要为激光雷达业务催化带来的投资机会。中际旭创是我们长期看好并跟踪的重点标的，公司一季报业绩亮眼且提到前瞻布局激光雷达，上周中报预告持续保持 40%+ 增长，然而 22 年 Wind 一致预期估值仅 20 倍左右，处于低位。我们认为本周以前股价受到压制的主要原因为旭创 80% 收入来自海外亚马逊、微软、谷歌、苹果、英伟达等科技巨头，市场对美国宏观经济环境、大客户资本开支、以及云计算产业链景气度过于悲观。周一因公司首次公开交流其激光雷达业务已有客户突破、正进行小批量测试验证，股价接近涨停。此外，天孚通信也将布局激光雷达业务，股价表现优异。激光雷达所需的光通信底层技术相通，且光模块公司在技术积淀、产能布局、制造能力等方面存在优势。激光雷达市场空间广阔（百亿美金），未来三年行业 CAGR 60%+，且市场竞争格局分散，格局未定，存在投资布局良机。**重点推荐：中际旭创、天孚通信、仕佳光子、长光华芯。**
- **【云计算行业应用】**6 月电网投资超预期，电力 IT 企业再受关注。4-5 月因疫情影响，部分电网投资项目有所延迟，但 6 月疫情有所恢复后投资强度大幅提升。随着新能源并网增加，电网复杂度提升，而配电网故障检测系统渗透率，配电网投资占比与增速有望持续提升。
- **我们重点推荐映翰通**，跟踪到公司在国网招标投标项目中表现优秀，市场对其 IWOS 产品的竞争力理解仍存在较大的预期差。除 IWOS 以外，公司持续丰富产品矩阵，过去两周内发布多项产品：高性价比工业路由器 IR302 助力工业机器人快速联网、高效运维；推出智能充电桩联网方案，帮助充电桩运营商与制造商实现充电桩的实时监控与远程管理；重磅发布智能收单柜，解决报销难题，推动企业财务智能化、标准化。基于通用的物联网、云计算、工业互联网平台技术，开发设计出工业级高稳定性和安全性产品，并高效孵化多行业和多场景解决方案，为客户创造可感知的价值，是公司核心竞争力。建议长期关注兼具技术壁垒与成长性的标的。

8、物联网产业链

- **物联网产业链观点：蜂窝模组上游芯片国产化率进一步提升，星链推出新服务卫星互联网加速推进。建议持续关注感知控制连接层以及下游大颗粒场景落地推进给上游带来的机会，重点推荐享受行业确定性的国内龙头及营收盈利成长稳健的公司。**
- **【产业动向】Counterpoint research 发布 2022 年一季度全球蜂窝物联网模块芯片出货量报告，全球出货量同比增长 35%，市场份额排名第一的是高通，市占率约为 42%；在此次 Counterpoint 统计的 8 家厂商中，有 5 家国内厂商上榜，分别是排名第二、第三的紫光展锐和翱捷科技，市占率分别是 25%和 7%，排名第五、第六、第七的移芯通信、芯翼信息、华为海思，市占率分别是 4%、4%、3%，尽管这三家厂商的市场份额较小，但可以看出国内厂商在全球蜂窝物联网芯片市场快速成长，下游模组厂商成本端有望受益于国产化率提升进一步提升盈利能力。卫星互联网方面，星链推出了更贵的服务 Starlink Maritime，主要给海洋、湖泊地区使用，每月套餐费用高达 5000 美元，约合 3.3 万元。海外厂商如 SpaceX、亚马逊等星链互联网等加速建设，新的商业模式及收费模式持续推出，我们认为，卫星互联网建设将成为下一次 ICT 基础建设重点，我国卫星互联网市场将迎来从卫星制造生产到下游应用，用的快速爆发。**
- **【模组赛道】根据 counterpoint 最新数据，22Q1 全球蜂窝物联网模块出货量增长 35%，其中移远通信（Quectel）、广和通（Fibocom）和日海智能（Sunsea）首次占据全球物联网蜂窝模块出货量的一半以上，东升西落趋势持续加强，其中移远通信 22Q1 同比增长 77%，市场份额占比 38%，值得注意的是，全球最大的 EMS 富士康也进入了全球前十大模块厂商名单，在 CPE 和连接 PC 领域的需求不断增长。我们认为未来模组通信制式持续往两个方向演进，一是高带宽、高速领域，4G 向 5G 升级，5G 渗透率将逐渐提高；二是窄带宽、低速领域，2G/3G 加速退网，向 Cat.1/eMTC/NB-IoT 等 LPWAN 制式转变，我们认为随着上游芯片短缺缓解，模组厂商 22 年有望实现毛利率回升。从 21 年及 22Q1 业绩来看，模组行业分化初现端倪，建议重点行业龙头，移远通信（平台型模组厂商，22H1 净利润增速 105%+）、广和通（关键转型期模组厂商，收购 SW 海外车载业务，车载模组 22 年可量产）、美格智能。**
- **【智能控制器赛道】智能控制器受益于下游产品智能化程度提升及东升西落趋势利好，万亿级别空间，是长期受益赛道，短期看上游芯片原材料短缺问题缓解。另外智能控制器厂商基于技术复用性具有生产储能相关配套产品技术能力，未来有望受益于新能源储能赛道增长，可持续重点关注。重点推荐拓邦股份（电动工具智控器龙头，布局锂电储能业务）、智能控制器厂商和而泰（家电智控器龙头，进军汽车电子，累积订单 80 亿+）。**
- **【下游大颗粒场景】1）卫星互联网：国内卫星互联网 2022 年有望迎来真正的发展元年，国内卫星制造产能扩张+发射进程加速，投资策略上建议制造先行，再转向产业链下游，建议关注华测导航及卫星射频芯片供应商和而泰；2）智能汽车：电动汽车智能化下半场已开启，建议从全球化扩张、国产化替代、新赛道洗牌等三个维度把握供应链智能化的投资机遇，建议关注光庭信息（专业第三方汽车软件）、经纬恒润、华测导航（高精度车载定位产品）；3）家庭互联网：下游家电智能化持续加深趋势不改，短期仍看智能单品及多品互联机会，中长期平台型公司空间广阔，建议关注涂鸦智能（物联网连接第三方平台）；4）工业互联网：持续看好工业互联网在中国产业转型升级的重要角色，建议关注工业富联（入选双跨平台，已有 5 座灯塔工厂）。**

9、计算机产业链观点

- **【金融科技】收入端，金融 IT 公司上半年不同程度地受到疫情影响，预计银行 IT 受影响程度弱于券商 IT。费用端，尽管上半年各家公司招聘都相对谨慎，但仍受到去年人员基数高增的影响，有相对较高的刚性费用支出。我们认为收入费用的增速剪刀差将于 Q3 开始转正，届时预计将迎来较高的利润弹性。板块依然首推恒生电子，预计全年营收预期不变、控费更加**

严格，利润拐点有望于 Q3 开始显现，建议中报左右积极关注。弹性标的首推指南针，公司 Q3 开始进行券商经纪业务的恢复，届时有望逐步兑现互联网券商的成长逻辑。低估值标的建议关注宇信科技及顶点软件。

- **【智能驾驶】**近期中科创达、四维图新陆续发布中报业绩预告。中科创达业绩并未受到疫情影响；四维图新智云和智芯收入大幅增长，而商用车车联网以及面向政企客户的大数据服务不及预期。我们认为下半年中科创达的景气度仍将持续；而四维定点的头部车厂 L2 级自动驾驶辅助系统将开始量产、且车规级 MCU 持续放量，若部分互联网公司造车提速，可能也会为公司带来更大的收入弹性。行业方面，2022 百度世界大会推出了第六代量产无人车 Apollo RT6，预计 2023 年下半年会小批量投入到萝卜快跑试运营、2025 年覆盖 65 个城市、2030 年覆盖 100 个城市。引人注目的是，RT6 成本仅为 25 万元、支持无方向盘模式、算力高达 1,200TOPS，且拿到了行业内第一个自动驾驶车规级的 ASIL D 认证。
- **【网络安全】**受益于网安行业持续不断的政策利好出台，叠加网络安全事件频发，疫情对业绩影响的悲观情绪在 2 季度已得到充分释放，随着十四五数字经济建设的节奏加快，板块整体估值水平已呈现中长期布局机会。考虑到客户采购及建设周期特点，下半年将迎来网安板块相关公司业绩兑现的收获期，建议积极关注板块的布局机会。预计下周开始国家大型攻防实战演习将正式开启，预计会带来关基行业客户安全需求加速落地，这部分需求带来的网安公司业绩将在 Q3、Q4 释放。考虑到国家《数据出境安全评估办法》自 2022 年 9 月 1 日起施行，叠加某互联网公司的巨额罚金事件的发酵，企业自证清白的数据安全建设步伐加速，预期将促进数据安全、隐私保护、数据跨境流动安全评估等场景的全行业客户需求增量快速释放，建议关注奇安信、安恒信息等。
- **【信创】**受益于“十四五”规划的逐步落地，加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强是数字经济持续健康发展的重要保障。同时面对愈发复杂的网络空间环境，全链条信息技术创新迫在眉睫。国家信创产业链的节奏稳步前行，今年下半年相关行业信创政策将继续出台，信创产业链有望在 9 月份继续演绎。
- **【人工智能】**安防龙头公司因为外媒制裁传闻而阶段性跑输，市值波动的隐含假设接近将公司海外业务归零，综合各方信息，我们认为公司进入 SDN List 的概率低，且公司的长期积累、坚定投入、业务多元布局等积极主动作为的要素，在经营层面持续体现出超出行业和友商水平的韧性。中期看，21-23 年，公司预计将迎来新一轮发展机遇期，短期看，下半年预计随着宏观环境回暖，业绩增速逐季度加速，而目前估值处于历史底部，大概率存在错杀，一旦负面因素逐步消除，预计将迎来新一轮极佳投资机会。
- **【数字经济】**近日，苏州、上海先后印发《数字经济发展“十四五”规划》；23 日，第五届数字中国建设峰会大数据论坛在福州举办。与会嘉宾围绕数据要素市场化、大数据基础能力建设、产业链优化升级、行业融合应用、产业规范治理等议题展开研讨和分享。7 月 28-30 日，全球数字经济大会即将在北京召开。预计数字经济主题将持续得到催化。
- **【工业软件】**近日，CAD 厂商浩辰软件 IPO 过会，EDA 厂商华大九天上市，流程行业软件与智能制造龙头中控技术半年度业绩预告继续保持高增长，作为制造业大国的软肋，工业软件领域将持续获得自上而下的支持，迎来良好的国产化发展机遇期。

二、行业重要资讯

- **中国信通院：6 月国内市场手机出货量同比增长 9.2%。**据中国信通院发布最新数据，6 月国内市场手机出货量 2801.7 万部，同比增长 9.2%，其中，5G 手机 2302.7 万部，同比增长 16.3%，占同期手机出货量的 82.2%。数据显示，6 月智能手机出货量 2747.8 万部，同比增长 9.1%，占同期手机出货量的 98.1%。2022 年 6 月，智能手机上市新机型 28 款，同比下降

6.7%，占同期手机上市新机型数量的 82.4%。国产品牌手机出货量 2451.4 万部，同比下降 0.5%，占同期手机出货量的 87.5%；上市新机型 32 款，同比增长 14.3%，占同期手机上市新机型数量的 94.1%。1-6 月，国内市场手机总体出货量累计 1.36 亿部，同比下降 21.7%，其中，5G 手机出货量 1.09 亿部，同比下降 14.5%，占同期手机出货量的 80.2%。

- **现代汽车、ABB 和 Electrolux 高管称芯片短缺状况有所缓解。**TechWeb 7 月 22 日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，现代汽车、工厂机器人制造商 ABB 和瑞典冰箱制造商 Electrolux 的高管表示，半导体芯片短缺状况有所缓解。据悉，自 2020 年下半年以来，芯片短缺问题就成为半导体行业的主旋律，该问题对包括汽车、手机、游戏机、PC 在内的产业产生了影响。在全球芯片短缺和尖端芯片竞争加剧的情况下，包括英特尔、台积电和三星电子在内的芯片制造商都在进行大量投资，从而使得芯片供应增加。外媒报道称，芯片供应的增加将减轻制造业面临的巨大压力，该行业目前面临着原材料价格上涨、能源市场吃紧以及利率上升等问题，这些因素都抑制了消费者的需求。除了现代汽车、ABB 和 Electrolux 的高管表示芯片短缺状况有所缓解外，高通首席执行官（CEO）克里斯蒂亚诺·阿蒙（Cristiano Amon）也曾在 2021 年 12 月初表示，全球芯片短缺情况正在缓解，预计 2022 年情况将有所改善。当时，阿蒙表示，与 2020 年相比，2021 年的芯片供应情况有所改善，预计 2022 年的情况将改善得更多。
- **5 月德电子电气行业进出口均实现两位数增长，对华出口增长 9.2%。**德电子电气工业协会（ZVEI）网站 7 月 14 日发布数据显示，5 月德电子电气工业出口额 191 亿欧元，同比增长 11.9%，是今年以来首次实现两位数增长，通胀是一部分原因，进口额 196 亿欧元，同比增长 21.2%。1 至 5 月，行业出口额 952 亿欧元，同比增长 5.8%，进口额 1001 亿欧元，同比增长 14.3%，外贸逆差约 50 亿欧元。5 月德电子电气行业对欧元区出口同比增长 8.8%至 59 亿欧元，对欧元区以外国家出口增长 13.4%至 132 亿欧元，其中对华出口 22 亿欧元，增长 9.2%，对美出口 20 亿欧元，增长 34.6%。5 月行业对俄罗斯和乌克兰出口持续下滑，对俄出口下滑三分之二至 1.07 亿欧元，对乌出口下滑超过三分之一至 2700 万欧元。1 至 5 月，德电子电气行业对欧元区出口 309 亿欧元，同比增长 4.4%，对欧元区以外第三国出口 643 亿欧元，同比增长 6.5%。
- **2022 上半年销售收入 1400 亿+ 游戏正在突破传统认知，成为“超级数字场景”。**7 月 21 日，中国音像与数字出版协会游戏工委与中国游戏产业研究院发布了《2022 年 1-6 月中国游戏产业报告》。报告显示，今年上半年，中国游戏市场实际销售收入为 1477.89 亿元，同比下降 1.8%；用户规模约 6.66 亿人，同比下降 0.13%。
- **内存、SSD 疯狂降价 第二大存储芯片厂商 SK 海力士将削减投资。**今年以来，内存及 SSD 价格走势转向熊市，价格不断下滑，再加上全年 PC、智能手机需求减少，Q3 季度还会进一步下跌，这也促使存储芯片厂商采取保守策略，第二大存储芯片厂商 SK 海力士就削减了投资计划。7 月 15 日，知情人士透露，全球第二大存储芯片制造商 SK 海力士考虑将 2023 年资本支出削减约四分之一至 16 万亿韩元（约合 122 亿美元），以应对电子产品需求慢于预期的局面。知情人士称，SK 海力士正基本按计划推进今年支出约 21 万亿韩元以建设 DRAM 和 NAND 产能。不过，由于智能手机、服务器等各个领域的芯片需求下降的不确定性，迫使该公司重新考虑明年的扩张计划。此前据行业调研公司集邦科技的报告，今年二季度，主要存储芯片 DRAM 内存的平均合同价格同比下跌 10.6%，为 2 年来首降，另一种存储芯片 NAND 价格也没好到哪里去，价格也在波动中。不仅二季度跌，目前的三季度中情况还会更坏，集邦科技预测内存平均合同价格将环比下跌 21%，NAND 闪存的环比价格跌幅则在 12%。
- **字节跳动自研芯片，传 3 倍薪资从华为海思、高通、ARM 等挖人。**7 月 19 日，字节跳动公司发言人证实，公司正在考虑设计自己的芯片。因为公司无法找到能够满足其要求的供应商。而这些针对需求定制的芯片将帮助处理字节跳动在视频平台、信息和娱乐应用等业务领域的相关工作负荷。7 月 21 日，据媒体报道，字节跳动副总裁杨震原称，字节的自研芯片探索主

要围绕自身视频推荐业务展开，研发团队将为字节大规模视频推荐服务专用场景定制硬件优化，如视频编解码，云端推理加速等，以期提升性能，降低成本。公司无通用芯片商业计划，没有涉足 CPU、GPU 等通用芯片业务。除了主要采购 X86 芯片，字节也和芯片供应商探索 RISC 架构芯片在云端的使用。据投资界报道，字节跳动从华为海思挖人，基本上“三倍挖人”。报道引述华南一家 AI 芯片公司的资深架构工程师李波的说法：「我所知道的情况是，海思的 15 级到字节给 3-1，不仅薪资翻倍，职级也是猛增。」华南一家 AI 芯片公司的资深架构工程师李波介绍，在华为，员工起步是 13 级，15 级能获得大约 35 万年薪，无期权；而字节 3-1 对应的是高级专家，中层领导。」此外，报道还称，除了华为，字节跳动还从高通、ARM 等公司挖了一些骨干，业内人士称，这样的大牛都能挖来，薪资应该是一个不敢想象的数字。目前，在脉脉等招聘平台上，字节跳动已开放招聘超过 30 个岗位，包括“芯片验证工程师”、“芯片、板级热设计工程师”、“芯片后端设计师”等，薪资最高达百万。

- **IC Insights: 中国大陆半导体研发支出仅占美国 1/18。** IC Insights 对半导体行业研发支出的最新年度报告显示，尽管美国国内半导体生产存在政治和国家安全问题，但美国公司仍占全球芯片行业研发总支出的一半以上。IC Insights 表示，2021 年全球半导体行业约 56% 的研发支出来自总部位于美洲地区的企业——基本上所有这些公司都在美国，其中很大一部分来自英特尔（去年为 19%，即 152 亿美元）。而中国大陆企业去年占半导体行业研发支出的 3.1%（近 20 亿美元）。图 1 显示 2021 年亚太公司（包括晶圆代工厂、无晶圆厂芯片供应商和集成设备制造商（IDM））的半导体研发支出超过全球总额的 29%，其次是欧洲公司，约占 8%，以及日本占行业支出的近 7%。自 2011 年以来，总部位于美洲的芯片供应商在全球半导体研发支出中所占的份额从近 55% 略有增长，亚太地区公司（包括中国）约占 18%。
- **三星计划斥资 2000 亿美元扩大得州芯片产能，或新建 11 家工厂。** 据国外媒体报道，三星电子提出了在未来 20 年投资近 2000 亿美元在德克萨斯州新建 11 家芯片制造厂的申请，如果实施这一巨额投资，将大幅提升其在美国的半导体立足点。该公司最近提交了 11 份申请，寻求获得税收减免。这些申请属于今年即将到期的第 313 章激励计划，该计划为大型投资提供为期 10 年的财产税减免。这将于周三下午发布在德克萨斯州审计长的网站上，这将意味着 1920 亿美元的投资和大约 10,000 个工作岗位的潜力。据了解，其中九个新工厂将位于泰勒，可能会利用第一家此类工厂所需的基础设施投资。其余两座计划设在奥斯汀，值得注意的是三星自 1996 年以来就开始在奥斯汀建有工厂。目前的三星奥斯汀工厂负责 CPU 和 DRAM 的生产。如果三星的所有计划都能实现，其中约有 245 亿美元投在奥斯汀，并可提供 1,800 个新工作岗位。1,676 亿美元会投在泰勒，提供 8,200 个新工作岗位。根据三星声明，目前还没有具体的建设计划，而且假设提议在各种情况下都可能发生变化。即使三星真的着手进行，第一个新的生产设施也要到 2034 年才开始运营。三星透露，提出计划的部分原因是为了在今年计划到期前，争取德州政府的财政补贴措施。
- **台积电正式量产 3 纳米。** 据台湾地区媒体报道，台积电 3 纳米制程近期投产，受传言激励，台积电昨天尾盘股价劲扬，重返新台币 500 元大关，终场收在当天最高点 501 元，涨幅 1.21%，市值增加 1,556 亿元（新台币），来到 12.99 万亿新台币。
- **韩媒称三星电子 3nm 芯片将于 7 月 25 日上市。** 据韩媒 BK 消息显示，三星电子将于 7 月 25 日举行 3nm 纳米芯片上市仪式，且产品在功耗、性能和面积方面有了显著改善。据悉，三星电子 6 月 30 日曾宣布，他们采用全环绕栅极晶体管架构的 3nm 制程工艺开始初步生产芯片，在业内率先开始采用 3nm 制程工艺代工晶圆。自三星电子 3nm 官宣生产后，业界便十分关注三星电子 3nm 芯片的首批客户。对此三星电子表示，第一批接收的买家是中国的加密货币矿工，但是其未对名称进行透露。据韩媒 TheElec 援引消息人士的话报道称，三星 3 纳米工艺的首个客户或许是中国比特币挖矿用半导体厂商——上海磐矽半导体有限公司(PanSemi)。

- **继英特尔、高通、Marvell 后，消息称德州仪器、博通计划上调部分芯片价格。**据台媒报道，德州仪器和博通准备提高芯片价格，已通知客户涨价计划。德州仪器预计第三季度将服务器 IC 等产品价格上调 10%，博通预计 2023 年 1 月将网络通信芯片价格上调 6%至 8%。有关涨价原因方面，德州仪器表示，尽管消费电子的市场需求低迷，但是汽车电子和工控等市场的需求依然强劲。近期，由于服务器 IC 的上游物件涨价，所以德州仪器准备提高相应产品的价格。博通则表示，由于各国推进 5G 项目建设，5G 和 Wi-Fi 6 的需求强劲，网络通信芯片处于供不应求的状态。因此，博通决定上调网络通信芯片价格。除此之外，近期还传出英特尔、Marvell 和高通将涨价。消息称，英特尔即将在今年秋季调涨全线产品价格。Marvell 也传出即将在 8 月 1 日将按客户与供不应求产品，调涨幅度在 7-8%。高通则被传出已经在近期通知客户涨价计划，最新下单是调涨 4%，在 2023 年 1 月交货的订单调涨最高 10%。
- **Omdia: 预计 2028 年全球 XR 应用近眼显示面板出货量 1.39 亿片。**据 Omdia 的追踪预测显示，面向近眼显示应用的显示面板出货量预计将在 2022 年达到 2530 万片，同比增长 73.8%，之后有望在 2028 年达到 1.39 亿片。有两大主要推动因素——首先，XR 终端设备的销量同比有所增长，从而推动了面板需求量的上升；其次，品牌商倾向于采用两块面板的设计代替原来一块面板的设计，以此改善用户的视觉体验，从而也推动了显示面板需求量的上涨。另据 Omdia 预测，营收同比增长高峰将出现在 2023 年，主要原因在于该年预计会有越来越多的品牌把硅基 OLED (OLEDDoS) 用于近眼显示设备——其较高的单价将成为收入增长的强大推动力。而长期来看，由于所有技术类别的显示面板在均价上都会表现出下滑趋势，因此收入增速将逐渐趋于平稳。
- **美国参议院通过的 520 亿美元芯片法案。**美国参议院于 7 月 19 日初步投票中，以 64 票对 34 票通过了 520 亿美元芯片法案，为该法案的最终通过铺平了道路。该法案旨在强化美国本土的芯片工厂建设，以提升市场竞争。该法案旨在应对来自其他国家的日益激烈的竞争，将向英特尔公司、三星电子有限公司、台积电和格芯等公司提供款项，用于在美国建设芯片工厂。芯片法案具体措施包括 520 亿美元的补贴和投资税收抵免。该芯片法案主要对英特尔、德州仪器和美光科技等芯片制造商有利，而 AMD、高通和英伟达等芯片设计商则不会获得直接好处。“芯片法案”脱胎于旨在提振美国的高科技研究和制造以对抗中国及其他竞争对手的“美国创新与竞争法案”。此前，参众两院分别推出各自版本的“竞争法案”，但因法案涵盖内容太过庞杂，两院分歧严重，久拖不决。据报道，为结束这一僵局，新法案将抛弃参众两院过去一年左右在不同版本中批准的除半导体外的几乎所有其他内容。虽然美媒对“芯片法案”在参议院投票通过的预期比较乐观，但众议院是否支持该法案尚未可知。
- **韩国目标到 2030 年实现 50%芯片材料供应本土化。**7 月 21 日，韩国政府表示，其目标是到 2030 年，实现半导体制造产业链中一半的原材料、部件和设备可以在本土采购，目前这一比例只有 30%。这是韩国尹锡悦政府芯片产业强化战略的一部分。拥有全球最大存储芯片制造商三星和 SK 海力士的韩国，正寻求加强供应链的资源保障和稳定性，以打造成为该领域的“超级大国”。韩国工业部等部委的一份联合声明表示，据芯片行业估计，目前韩国约 20%的芯片设备和 50%的原材料来自本地供应商。“尽管在自力更生方面取得了一些成就，但高科技和关键技术仍然高度依赖海外，”该声明还指出，中美贸易冲突和俄乌局势继续破坏着全球芯片供应的稳定。韩国工业部称，将扩大对芯片产业的税收激励和支持措施。韩国芯片产业计划到 2026 年总计投资 340 万亿韩元。其中，政府和私营部门将投资 3000 亿韩元用于小企业创新和芯片设计公司的兼并和收购，这项投资将于明年开始。韩国还将在 2024 年-2030 年花费 9500 亿韩元用于开发电力和车用芯片的可行性研究，到 2029 年前花费 1.25 万亿韩元开发人工智能芯片。此外，韩国政府将研究在作为扩大芯片生产中心的地区——包括平泽和龙仁，为电力和水供应等生产基础设施提供更多资金。政府还将考虑扩大对大公司的基础设施投资予以税收减免。根据该计划，韩国政府和私营部门将共同努力，在 10 年内培训至少 15 万芯片行业人才，以增强劳动力

储备。目前，半导体出口已连续 9 年占据韩国商品出口的首位。2021 年，半导体出口占韩国所有出口比重的 19.9%。

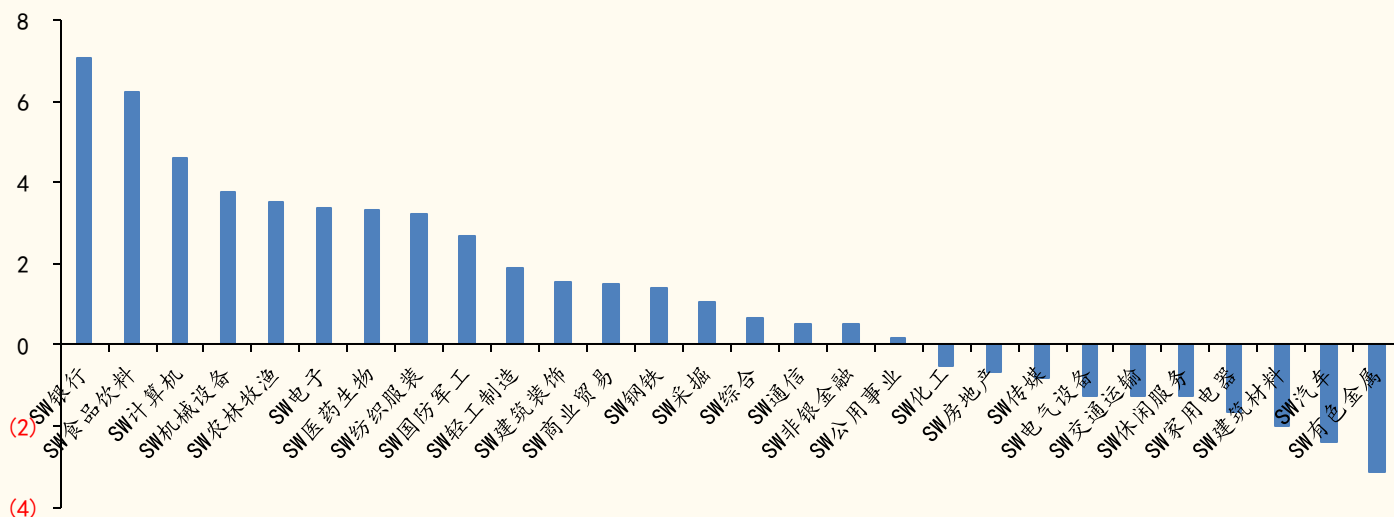
- **机构：6 月中国大陆 LCD 面板产线稼动率降至 75.6%，同比下滑近 20 个百分点。**市场调研机构 CINNO Research 月度面板厂投产调研数据显示，2022 年 6 月，中国大陆液晶面板厂平均稼动率为 75.6%，相比 5 月下滑 9.3 个百分点，同比 2021 年 6 月则下滑近 20 个百分点。其中，低世代线（G4.5-G6）平均稼动率为 74.5%，相比 5 月下滑 1.9 个百分点；高世代线（G8-G11）平均稼动率为 75.7%，相比 5 月下滑 10.2 个百分点，其中 G10.5/11 高世代线平均稼动率为 81.7%。6 月中国大陆 AMOLED 面板厂平均稼动率为 37.1%，相比 5 月下滑 4.3 个百分点，其中 G6 AMOLED 产线平均稼动率仅 33.1%，受手机品牌终端砍单影响，AMOLED 产线稼动率创下近三年新低。
- **ASML：全年营收成长预期由 20%下修至 10%。**半导体设备制造商 ASML 发布新闻稿，将全年营收成长预期由 20%下修约为 10%。此外，由于预计在 2022 年剩余时间内快速发货的数量增加其收入将推迟到 2023 年，约为 28 亿欧元。考虑到这种延迟营收入帐与增加产能相关的额外成本以及某些通胀趋势，预计 2022 年全年毛利率将在 49%至 50%之间。ASML CEO Peter Wennink 表示，一些客户以消费导向市场中显示出需求放缓的迹象，但在全球汽车、HPC 和绿色能源转型大趋势的推动下，仍然看到对公司系统的强劲需求。虽然仍计划在今年交货创纪录数量的系统，但日益严重的供应链限制导致启动延迟。因此将在今年内增加快速发货数量，以便为客户提供必要的产能扩张。

三、行业数据

1、报告期内行情

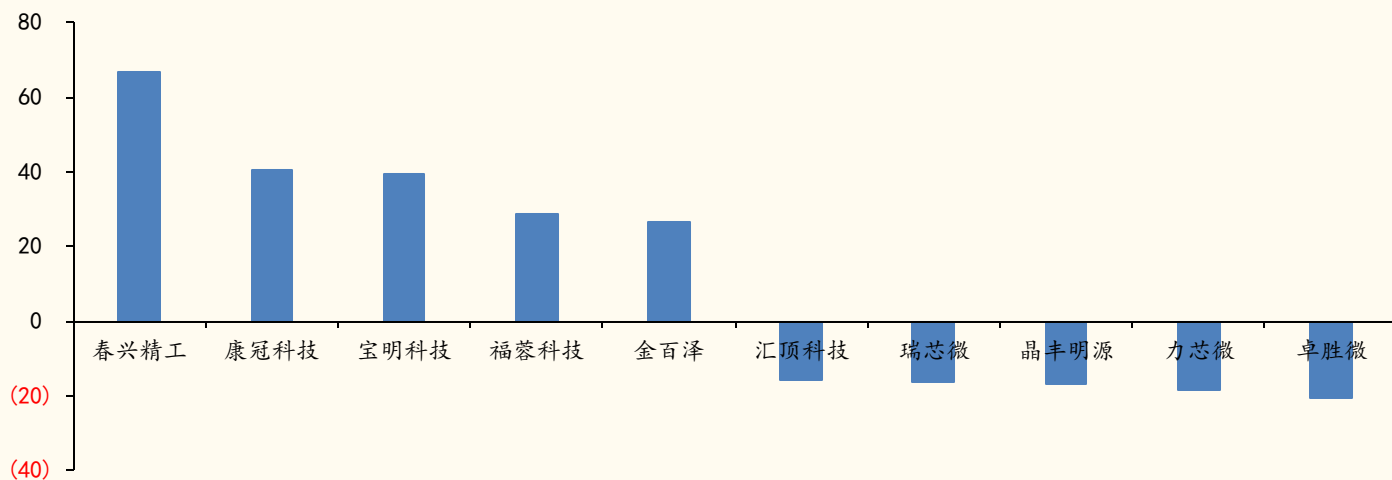
- 报告期内(07/11-07/24)上证 A 指下跌-2.57%，深证 A 指下跌 3.6%，其中电子行业上涨 3.4%。如图 2 所示。电子板块涨幅前五为春兴精工、康冠科技、宝明科技、芙蓉科技、金百泽。跌幅前五为卓胜微、力芯微、晶丰明源、瑞芯微和汇顶科技。

图表 2：报告期内 A 股各版块涨跌幅比较 (07/11-07/24)



来源：wind，国金证券研究所

图表 3：报告期电子行业涨跌幅前五名 (07/11-07/24)

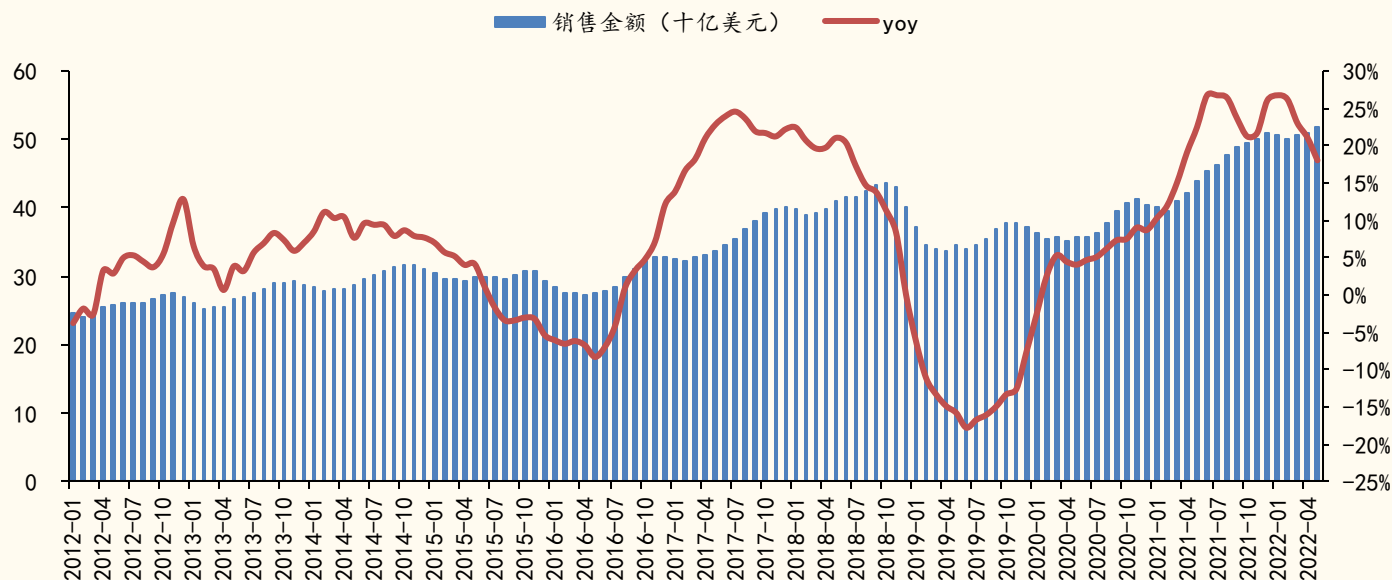


来源：wind，国金证券研究所

2、全球半导体销售额

- 2022 年 5 月份全球半导体销售额由前月的 509.2 亿美元提至 518.2 亿美元。与去年同期比较，5 月份全球半导体销售上升 18%。

图表 4：全球半导体月销售额

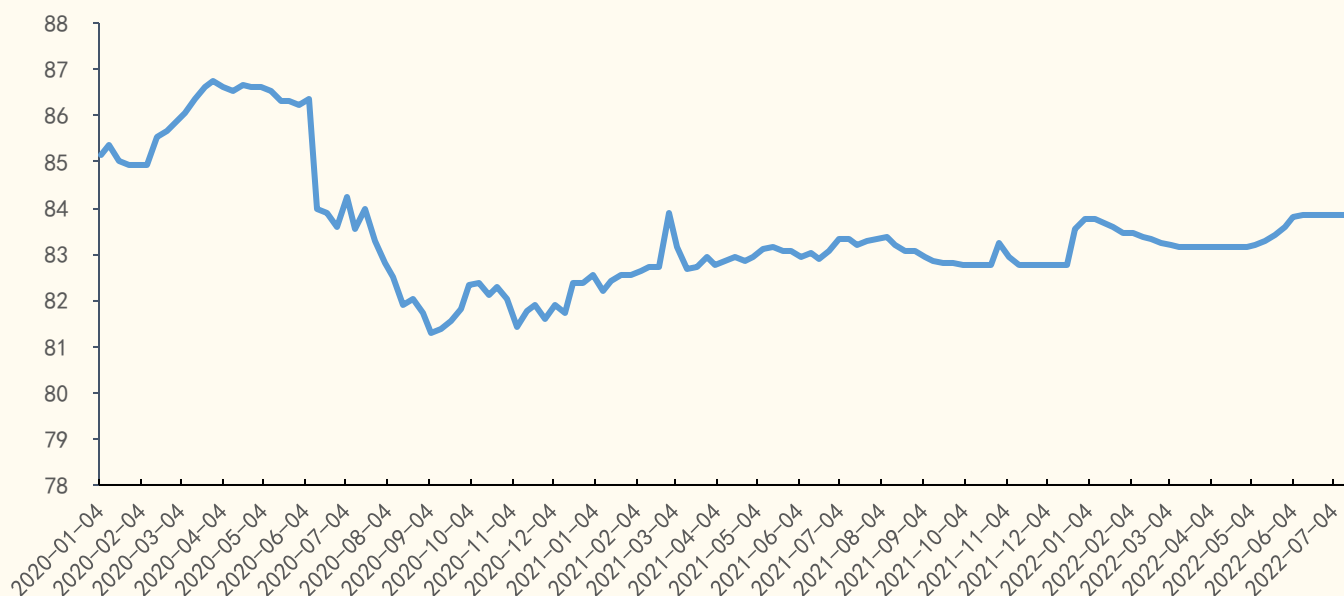


来源：wind，国金证券研究所

3、中关村指数

- 截至 2022 年 7 月 16 日，中关村周价格指数为 83.83，7 月以来与 6 月基本持平。

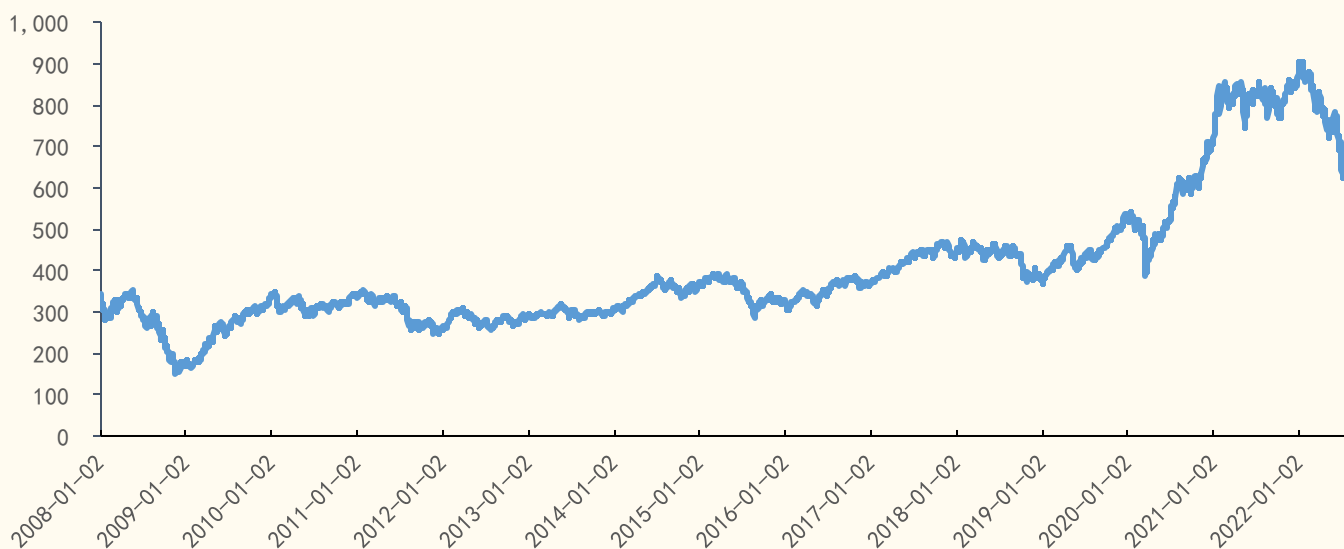
图表 5：中关村周价格指数



来源：wind，国金证券研究所

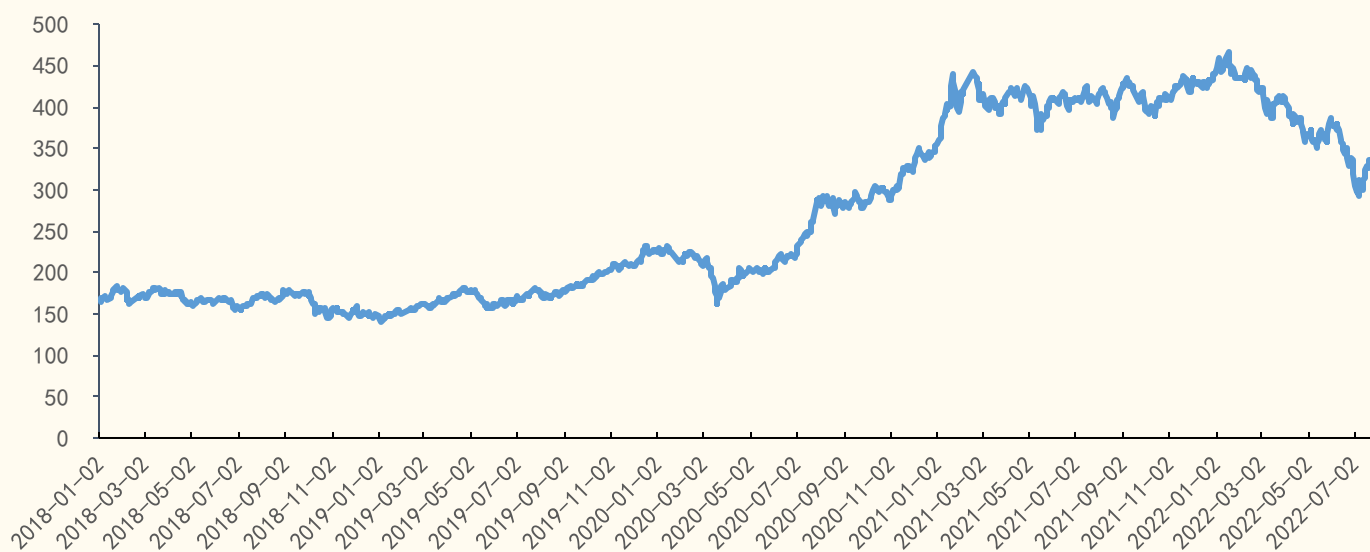
4、台湾电子行业指数变化

图表 6：台湾电子行业指数走势



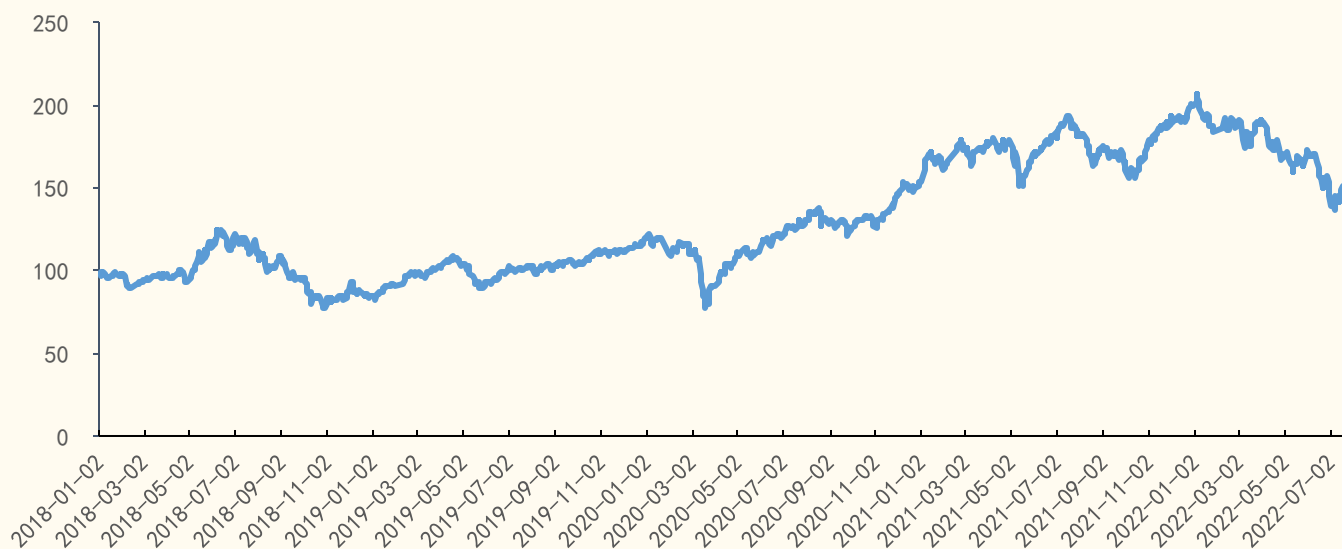
来源：wind，国金证券研究所

图表 7：台湾半导体行业指数走势



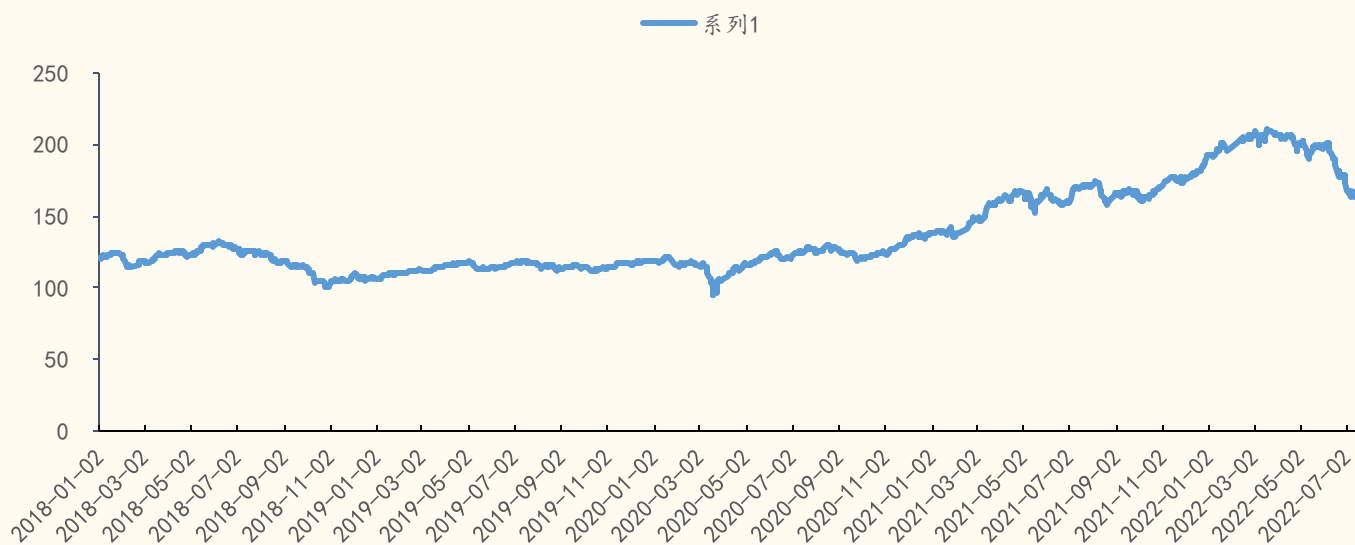
来源：wind，国金证券研究所

图表 8：台湾电子零组件指数走势



来源：wind，国金证券研究所

图表 9：台湾电子通路指数走势

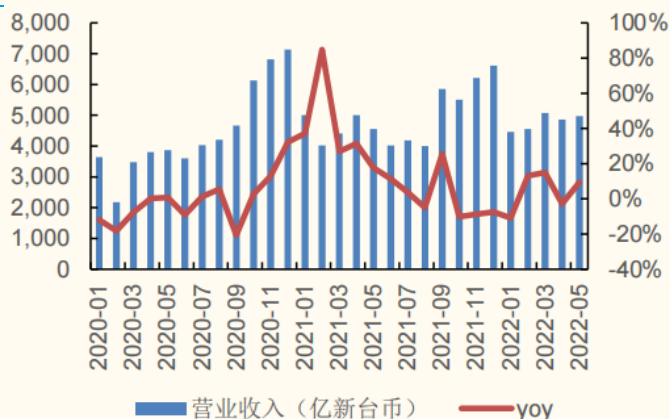


来源：wind，国金证券研究所

5、台湾电子半导体龙头公司月度营收

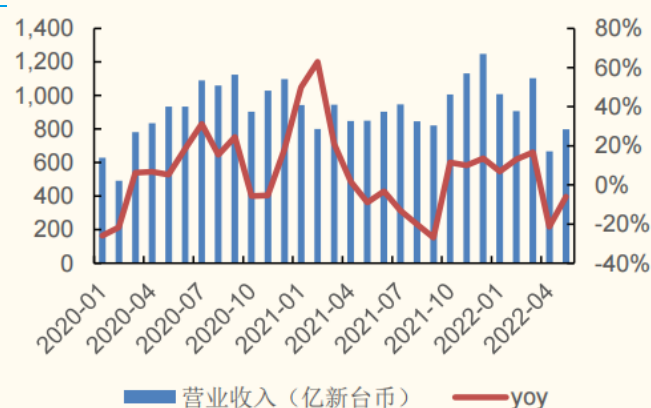
- 消费电子领域，鸿海、广达、华硕 6 月份月度营收同比增速分别为 31.02%、36.95%、15.55%。

图表 10：鸿海月度营收



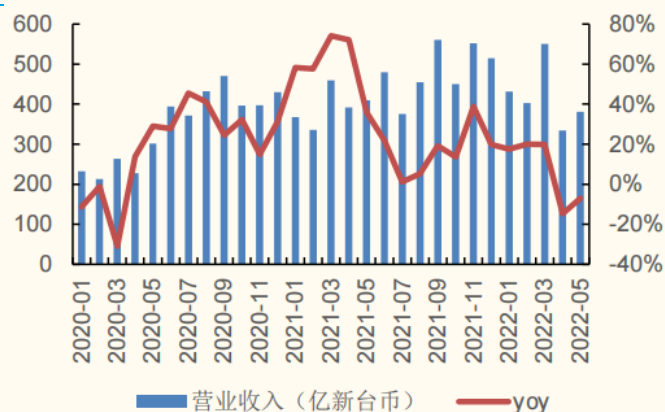
来源：wind，国金证券研究所

图表 11：广达月度营收

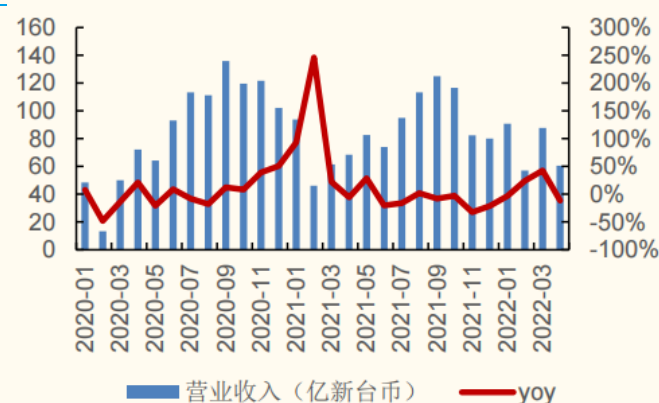


来源：wind，国金证券研究所

图表 12：华硕月度营收



图表 13：鸿准月度营收

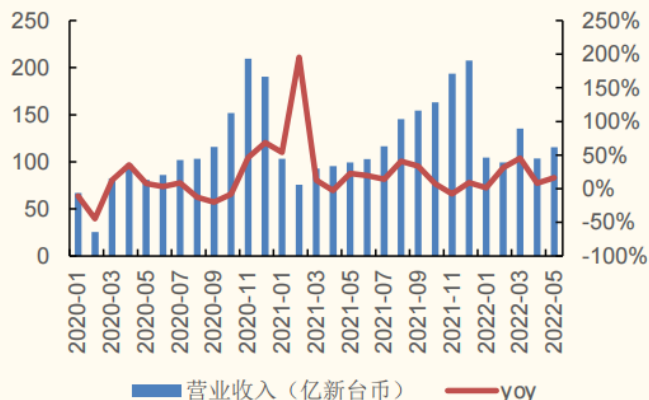


来源：wind，国金证券研究所

来源：wind，国金证券研究所

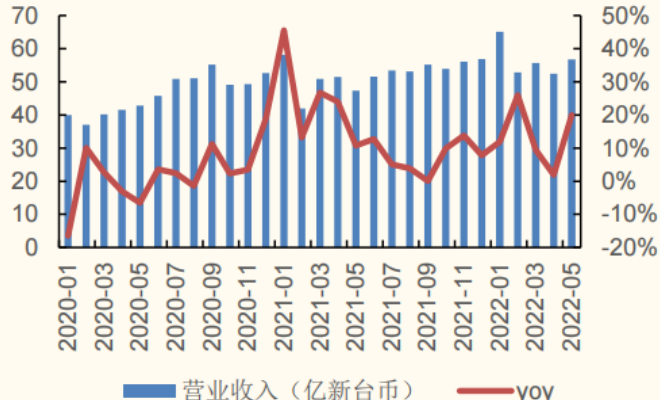
- PCB 领域，臻鼎、健鼎、欣兴 6 月份月度营收同比增速分别为 22.68%、9.38%、51.41%。

图表 14：臻鼎月度营收



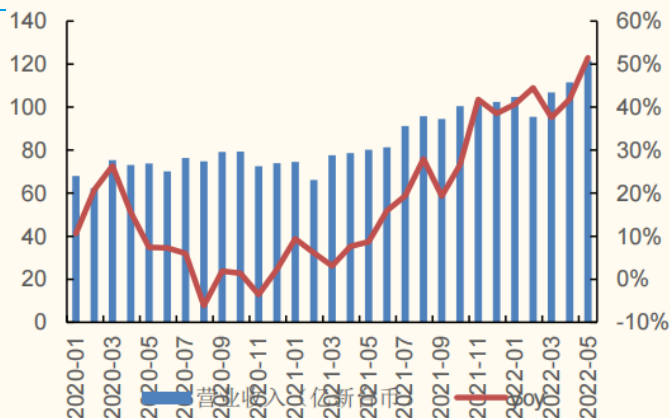
来源：wind，国金证券研究所

图表 15：健鼎月度营收



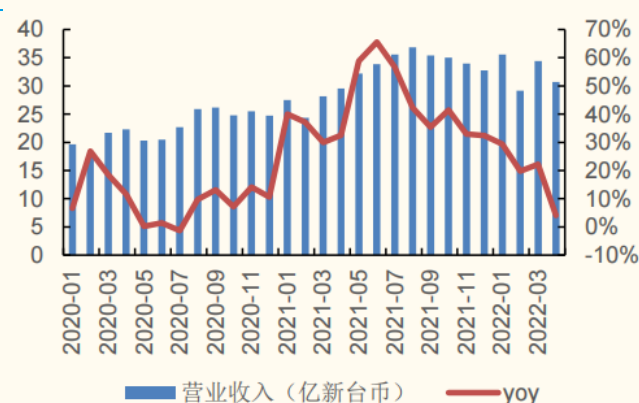
来源：wind，国金证券研究所

图表 16：欣兴月度营收



来源：wind，国金证券研究所

图表 17：台光月度营收



来源：wind，国金证券研究所

四、风险提示

- 新能源车、智能手机销量不及预期：新能源车和智能手机是电子元器件主要需求应用领域，如果销量不及预期，将拖累终端需求，使相关公司营收增长乏力。
- 智能化配置不及预期：乘用车辅助驾驶及自动驾驶将带动半导体、传感器、被动元器件等新的增量应用，如果智能化配置不及预期
- 估值偏高：全球及国内半导体公司普遍估值偏高，在通膨持续加温之下，下跌风险加大。

公司投资评级的说明：

买入：预期未来 6—12 个月内上涨幅度在 15%以上；
增持：预期未来 6—12 个月内上涨幅度在 5%—15%；
中性：预期未来 6—12 个月内变动幅度在 -5%—5%；
减持：预期未来 6—12 个月内下跌幅度在 5%以上。

行业投资评级的说明：

买入：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上；
增持：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%；
中性：预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%；
减持：预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。

特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海

电话：021-60753903

传真：021-61038200

邮箱：researchsh@gjzq.com.cn

邮编：201204

地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 7 楼

北京

电话：010-66216979

传真：010-66216793

邮箱：researchbj@gjzq.com.cn

邮编：100053

地址：中国北京西城区长椿街 3 号 4 层

深圳

电话：0755-83831378

传真：0755-83830558

邮箱：researchsz@gjzq.com.cn

邮编：518000

地址：中国深圳市福田区中心四路 1-1 号

嘉里建设广场 T3-2402